

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
股份代號：1398  
美元優先股股份代號：4620

## 關於對外投資的公告

### 一、本次投資概述

近日，中國工商銀行股份有限公司（「本行」）已和中華人民共和國財政部等19家機構簽署《國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司發起人協議》（「發起人協議」），擬向國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司（「基金」）出資人民幣215億元，持股比例6.25%，預計自基金註冊成立之日起10年內實繳到位（「本次投資」）。本次投資不屬於本行重大資產重組事項，不構成本行的關聯交易。

本次投資已經本行董事會於2023年11月30日審議通過。議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。鑒於本行董事會審議通過上述議案時，本次投資尚未完成協議簽署，基金尚未設立，存在不確定性，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號——信息披露事務管理》、《中國工商銀行股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理辦法》的有關規定，本行經審慎判斷，決定暫緩披露本次投資，並按相關規定辦理了暫緩披露的內部登記和審批程序。

本次投資無需提交本行股東大會審議。

本次投資已經國家金融監督管理總局批准。

### 二、投資標的基本情況

基金由中華人民共和國財政部等19家機構共同出資設立，註冊資本為人民幣3,440億元，經營範圍包括私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理諮詢等。基金旨在引導社會資本加大對集成電路產業的多渠道融資支持，重點投向集成電路全產業鏈。

### 三、本次投資對本行的影響

本次投資資金來源為本行自有資金。本次投資是本行結合國家對集成電路產業發展的重大決策、本行的發展戰略及業務資源作出的重要佈局，是本行服務實體經濟、推動經濟和社會可持續發展的戰略選擇，是本行踐行大行擔當的又一大舉措，對於推動本行金融業務發展具有重要意義。

### 四、本次投資的風險分析

根據《發起人協議》約定，本行應自基金註冊成立之日起10年內按照認購的股份全額繳納股款，根據《中華人民共和國公司法（2023修訂）》（2024年7月1日實施）等相關法律法規，上述出資期限安排尚需根據法律法規取得相關部門同意。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2024年5月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生、陳德霖先生和赫伯特·沃特先生。